

超音波光探傷装置MIV-X ワークショップのご案内

日時 令和7年3月17日～18日

会場 福井大学 文京キャンパス 産学官連携本部Ⅱ号棟3階

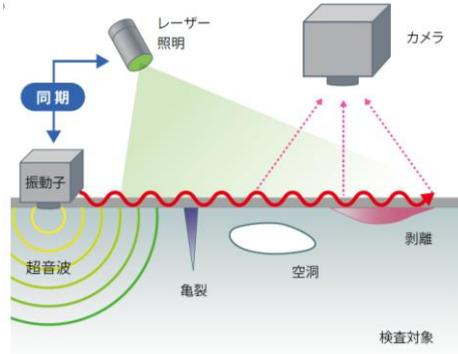
入場 無料 (定員になり次第, 締め切らせていただきます)

実演 **お客様の実試料**でお試しいただけます。

ワークショップ期間は弊社技術者が駐在しております。
また、お持ち込み頂いたサンプルはその場で測定いただけ、測定結果はお持ち帰りいただけます。

超音波光探傷装置MAIVIS : MIV-X

金属、セラミクス、複合材、異種接合材等の接合・接着面の剥離、
コーティング剥離や母材の亀裂など表層近傍の欠陥検知します。



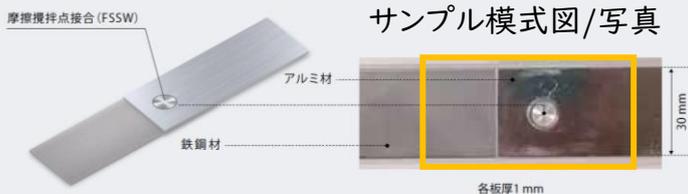
対象物に連続した超音波振動を
荷表面を伝搬する超音波による微小
な面外変位をレーザー照明とカメラで
光学的に可視化し、超音波の伝播が
乱れる様子を観測することで欠陥を
検知します。



アプリケーション例 黄枠が観察箇所/青枠が欠陥箇所

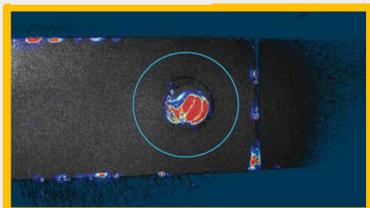
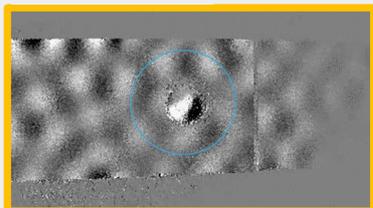
①Fe/Alの摩擦攪拌点接合

②CFRP-ステンレスの接着材料



観察結果像

解析結果像



観察結果像

解析結果像

